

Space qualification

September 2015

FC017 - FC020

RoHS option

TECHNOLOGY

Multilayer ceramic discoidal capacitor
 Silver paste mounted
 Resin/Resin or glass bead/resin sealing
 Gold or Silver plated metal housing
 Gold or Silver plated wire leads



GENERAL CHARACTERISTICS

Insulation resistance at U_{RC} : $\geq 10\,000\text{ M}\Omega$
 Withstand voltage : $2.5 U_R$
 Series resistance : $\leq 5\text{ m}\Omega$
 Maximum permissible current :
 • Wire diameter 0.42 mm : 5A
 Tangent δ at 1 KHz : $\leq 250 \cdot 10^{-4}$



TEMPERATURE RANGE

Standard model : $-55^\circ\text{C} +125^\circ\text{C}$

MOUNTING PRECAUTIONS

Absence silver paste on the ceramic
 Polymerization temperature : $150^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
 Polymerization time : 1h

MARKING on packaging

EFD
 Référence
 Quantité
 N° de lot
 Date-code (année-mois)

TECHNOLOGIE

Condensateur discoïde multicouche
 à diélectrique céramique
 Fixation par colle argent
 Obturation Résine/Résine ou Résine/perle de verre
 Boîtier métallique doré ou argenté
 Sorties par fils dorés ou argentés

CARACTERISTIQUES GENERALES

Résistance d'isolement sous U_{RC} : $\geq 10\,000\text{ M}\Omega$
 Tension de tenue : $2.5 U_R$
 Résistance série : $\leq 5\text{ m}\Omega$
 Intensité maximale admissible :
 • Diamètre de fil 0.42 mm : 5A
 Tangente δ à 1 KHz : $\leq 250 \cdot 10^{-4}$

GAMME DE TEMPERATURE

Version standard : $-55^\circ\text{C} +125^\circ\text{C}$

PRECAUTION DE MONTAGE

Absence de colle argent sur la céramique
 Température de polymérisation : $150^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
 Temps de polymérisation : 1h

MARQUAGE sur le conditionnement

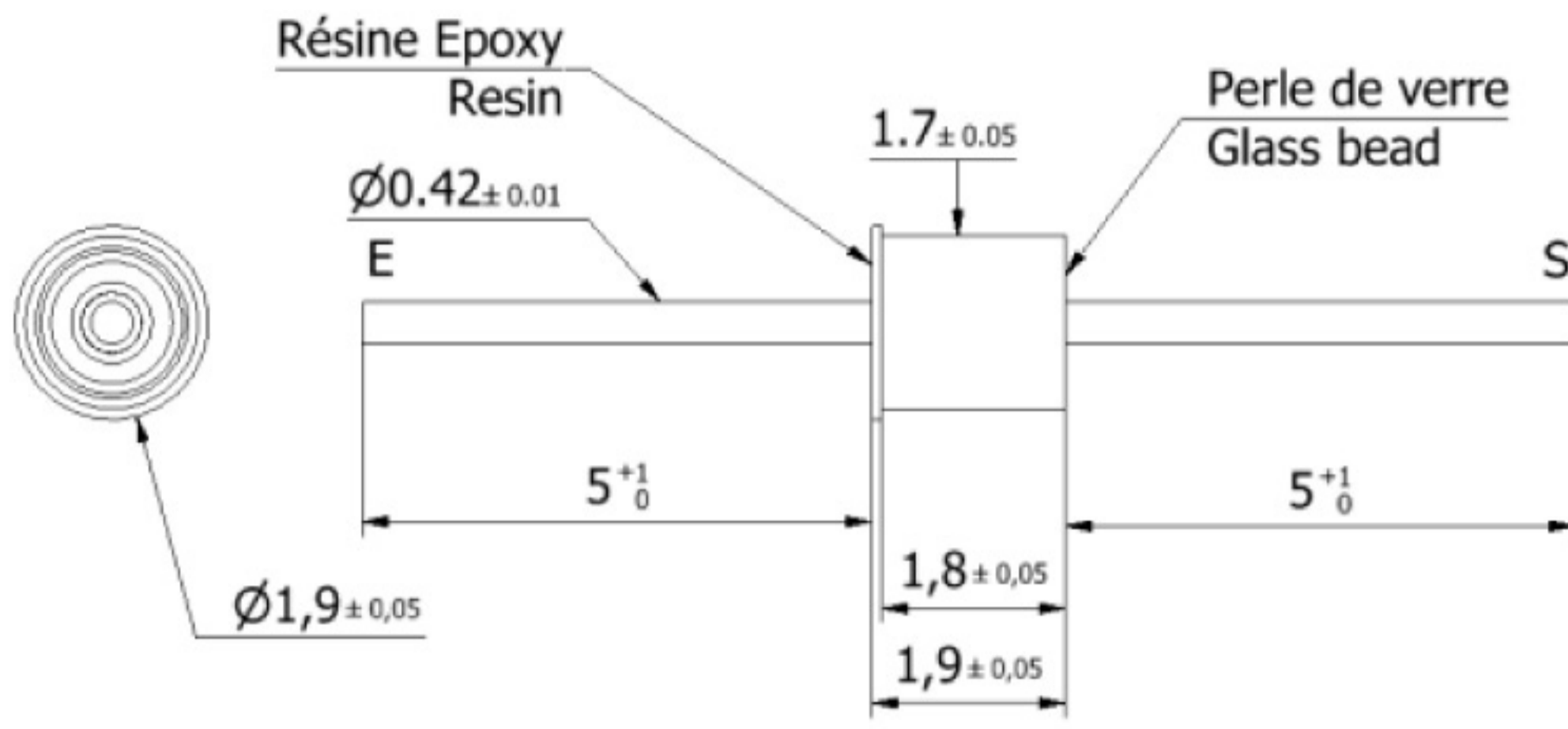
EFD
 Référence
 Quantité
 N° de lot
 Date-code (année-mois)



DRAFT - FC017-FC020

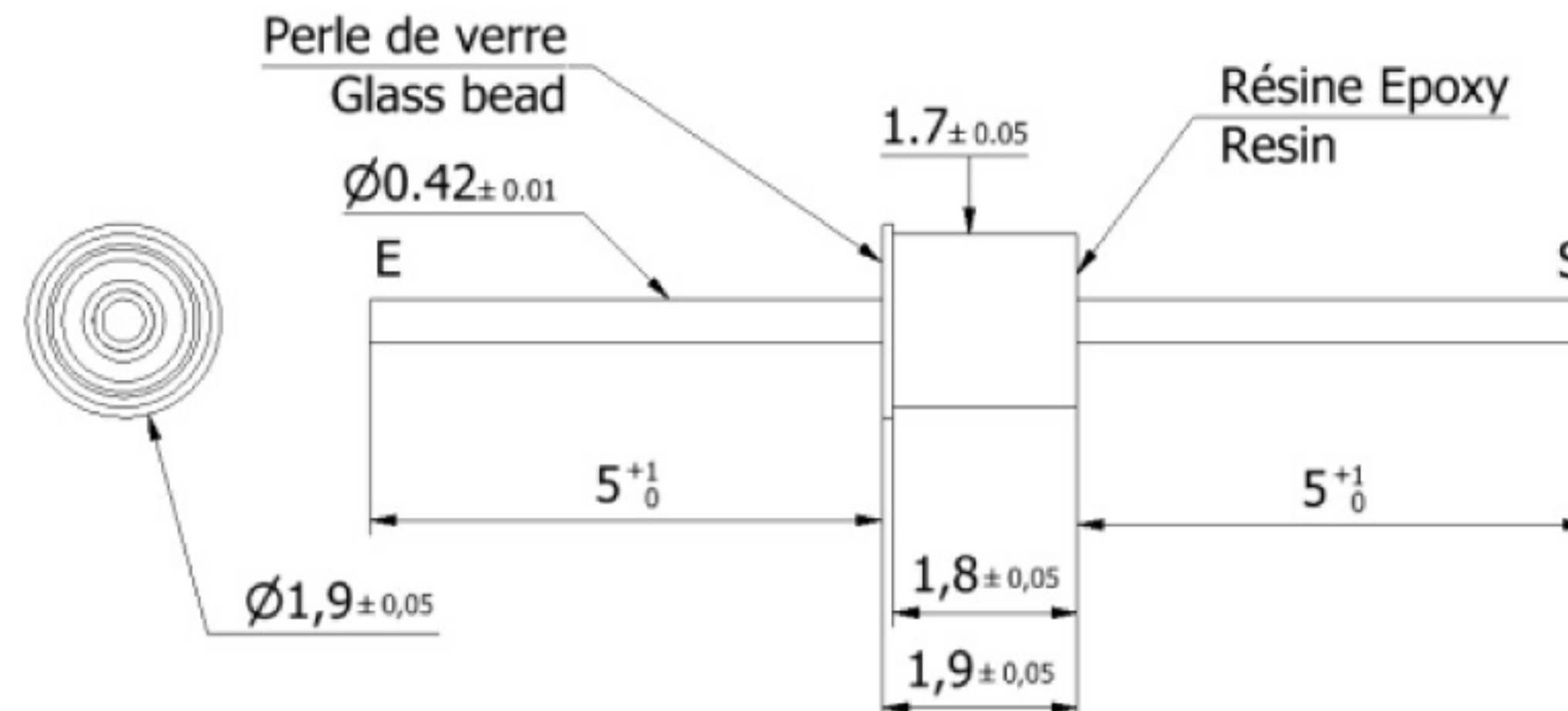
Version boitier à collerette (Obturation mixte)

External splines metal housing version (Mixed sealing)



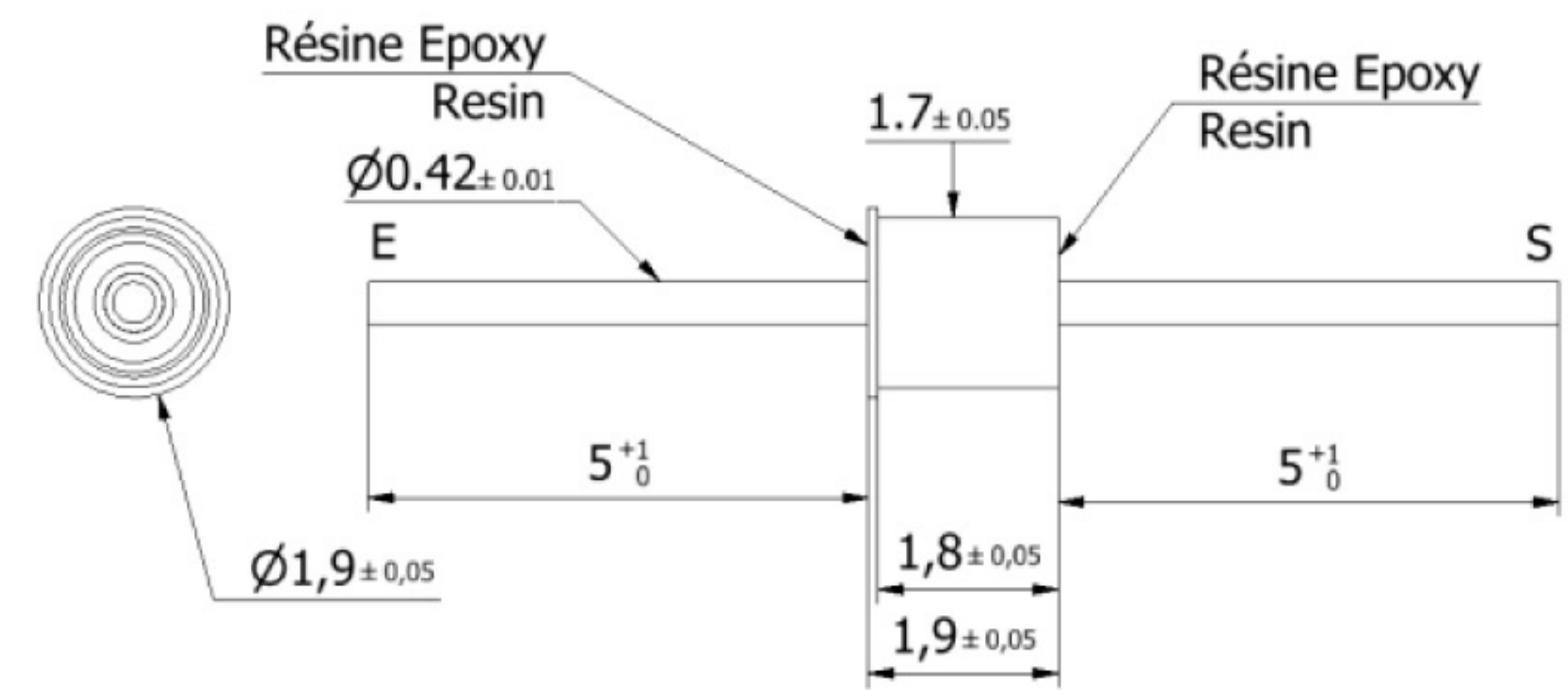
Version boitier à collerette (Obturation mixte inverse)

External splines metal housing version (Inverse mixed sealing)



Version boitier à collerette (Obturation résine)

External splines metal housing version (Resin sealed)



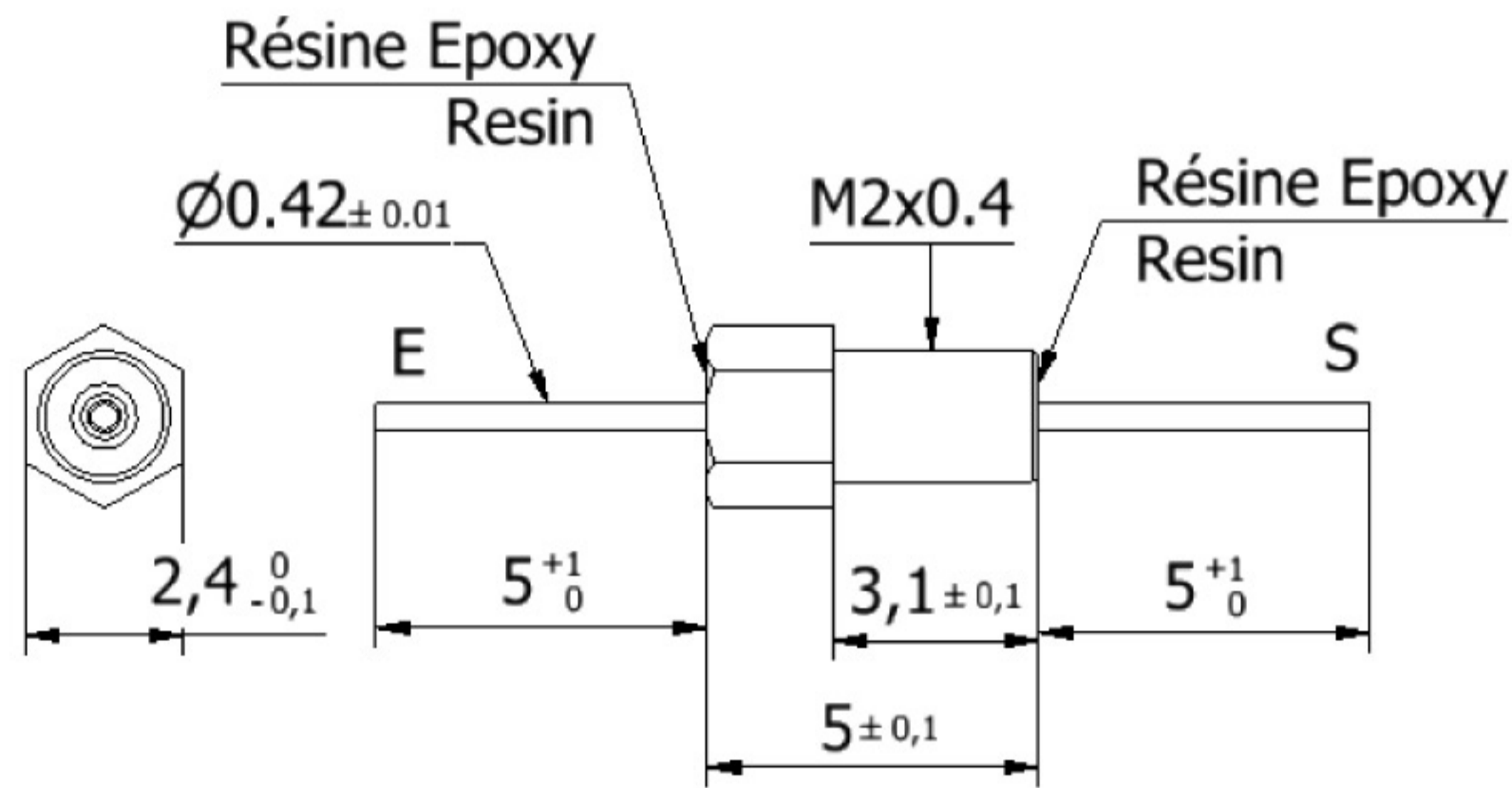
Boitier et sorties métalliques dorés ou argentés
Gold or silvered plated metal housing and outputs

Boitier et sorties métalliques dorés ou argentés
Gold or silvered plated metal housing and outputs

Boitier et sorties métalliques dorés ou argentés
Gold or silvered plated metal housing and outputs

Version boitier fileté avec tête hexagonale (Obturation résine)

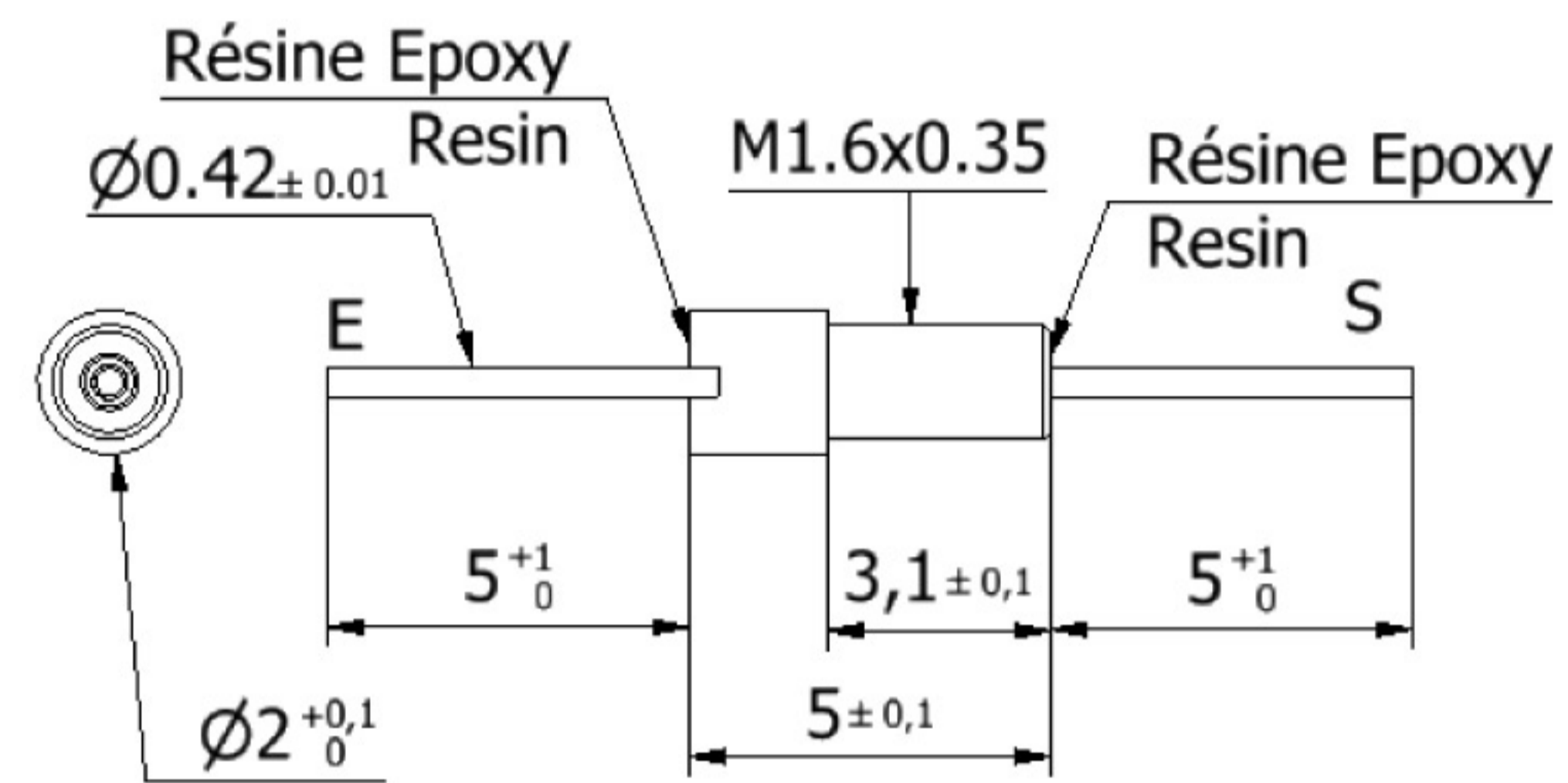
Thread metal housing version with hexagonal head (Resin sealed)



Boitier et sorties métalliques dorés ou argentés
Gold or Silvered plated metal housing and outputs

Version boitier fileté avec tête cylindrique fendue (Obturation résine)

Thread metal housing version with split cylindrical head (Resin sealed)



Boitier et sorties métalliques dorés ou argentés
Gold or silvered plated metal housing and outputs

Capacitance Value CR Tolerance CR ± 20%	Capacitance CR (in code)	UR rated voltage (VDC) (-55°C +125°C)		
		25 V	50 V	100 V
100 pF	101			
150 pF	151			
220 pF	221			
330 pF	331			
470 pF	471			
680 pF	681			
1000 pF	102			
1500 pF	152			
2200 pF	222			
3300 pF	332			
4700 pF	472			
Valeur de capacité CR Tolérance sur CR ± 20%	Capacité CR (en code)	25 V	50 V	100 V
		Tension nominale URC (Vcc) (-55°C +125°C)		

